

2026 年度 “提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告



华润微电子有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告

华润微电子有限公司（以下简称“公司”）牢固树立“以投资者为本、高质量发展”核心理念，结合战略发展规划及业务实际，于 2026 年 4 月 25 日发布《华润微电子有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司明确以稳健经营、规范治理与可持续回报为着力点，切实履行上市公司责任，筑牢长期价值根基。2026 年上半年，行动方案与公司整体战略协同推进，各项举措扎实落地，实施成效显著。现将上半年具体执行情况与主要成果报告如下。

一、坚持 IDM 商业模式，以高质量发展铸就价值根基

2026 年上半年，全球半导体行业在 AI 算力与端侧应用加速落地的双重驱动下，步入景气上行周期。受益于数据中心、新能源汽车、风光储及工业控制等领域结构性需求释放，带动功率、模拟及数模混合芯片等核心产品供需关系趋紧，市场整体回暖态势明显。公司凭借全产业链布局和特色工艺平台优势，精准把握行业上行窗口，订单获取充足，产能利用率维持高位，并基于成本变化及市场竞争策略适时调整产品价格，实现了经营质效的显著跃升，行业龙头地位得到进一步巩固。

（一）经营业绩稳中有进，盈利质量持续提升

2026 年上半年，公司累计实现营业收入 61.28 亿元，同比增长 17.44%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.22 亿元，同比增长 113.23%。

2026 年第二季度单季，公司实现营业收入 32.71 亿元，创单季历史最高，同比增长 14.24%；归属于母公司所有者的净利润 3.92 亿元，同比增长 53.53%，盈利水平进一步提升。同期，单季综合毛利率 27.61%，同比及环比分别提升 1.67 和 2.13 个百分点，产品结构升级与降本增效成效持续释放，整体经营呈现“稳中有进、进中提质、质中增效”的良好态势。

（二）重点项目有序推进，产能布局日趋完善

公司紧抓结构性增长机遇，加快推进重点产能与研发项目建设，持续强化产品集成能力与工艺技术纵深，不断夯实长期增长的内生动能。重点项目进展如下：

1. 参股的重庆 12 吋功率半导体晶圆生产线项目

重庆 12 吋项目聚焦主流高端功率器件，依托产线技术优势，重点围绕 MOSET（SJ/SGT）、IGBT 高价值产品，已建成产能 3 万片/月。**SGT MOS 产品**营收同比增长 40%，其中对标国际一流的先进代次（G5/G6）技术优势显著，产品在新能源汽车、风光储及智能电网领域表现强劲。**SJ MOS 产品**性能对标国际一流，有效满足 AI 数据中心、具身智能及低空经济等领域的高能效需求，其先进代次（G4）产品营收同比增长 255%。**IGBT 产品**新一代 G7 平台完成 650V-1200V 全系列产品开发并开启大批量供货。

2. 参股的深圳 12 吋集成电路生产线项目

深圳 12 吋项目聚焦 55-40nm 以上 BCD、HV、RF、Flash 等模拟特色工艺，重点围绕 MCU、电源管理、Driver、逻辑运算、存储及 RF 射频等产品，着力打造特色模拟 IC 生态。项目产能

有序释放，截至6月已超2.5万片/月，下半年爬坡节奏将进一步加快。前期合作客户逐步深入并已进入量产阶段，新客户研发进展顺利，整体订单投片逐月递增，产能结构持续优化，规模化效应逐步显现。

3. 先进功率封测基地

先进功率封测基地项目聚焦模块级、晶圆级、先进功率器件框架级、面板级等封装平台，在功率半导体高端封装及先进封装领域持续扩大产业规模，精准识别高附加值的“产品+应用”组合，重点覆盖汽车电子、AI+、机器人及智能穿戴等核心应用领域，提供高性能封装解决方案。先进封装方面，2.5D封装实现突破，PSiP平台具备量产能力；模块封装方面，多款碳化硅模块已与头部车企合作完成送样；先进功率封装方面，双面散热PPAK产品实现多个客户批量生产，同时完成SMP等车规封装量产。

4. 高端掩模项目

高端掩模新线运营成效显著，有效支撑业务持续发展。产品结构持续向高阶方向发力，180nm及以下技术节点中高端产品销售收入占比近60%。技术研发方面，90nm持续深化客户导入与验证，推进规模化产出；40nm已进入客户验证阶段，下一节点制程按计划启动研发。

二、加快发展新质生产力，聚焦技术和产品创新

公司围绕核心应用场景持续拓宽产品布局，以研发创新驱动产品迭代，以产品升级助推市场拓展，报告期内核心产品线均实现较快增长，IDM模式下多元化产品矩阵的协同效应进一

步释放。

（一）研发投入持续加码，创新成果加速转化

公司坚持高研发投入驱动创新与成果转化。报告期内研发投入达 5.25 亿元，占营业收入比重 8.57%。公司围绕主责主业布局关键技术攻关，填补技术空白并推动国产替代。主要研发成果包括：

1. 采用异构集成技术制造的双背板麦克风产品信噪比达 70dB，性能达到国际先进水平，双振膜产品完成全流程工艺开发。

2. 完成车规级高可靠性 MEMS 硅麦麦克风产品的开发，产品信噪比 66-68dB，补齐了国内车规 MEMS Mic "Fab+Sensor+ASIC" 全链条空白，实现国产替代。

3 第二代新型铁电存储 VFRAM 研发，完成首颗嵌入式 2M IP 电路测试开发和功能验证，器件性能达到国际领先水平（根据公开发布数据），形成可工程化落地的自主存储 IP。

4. 车规 AEC Q-100 Grade-1 标准的 150 纳米车规级深槽隔离 BCD 技术平台建设完成，高压逻辑器件隔离尺寸、SOI 200V NLDMOS 参数指标达到国际先进水平，该项目的实施促进了公司在该领域整体技术水平的提升，填补了公司相关技术空白。

5. 国内首批拥有规模制造能力的全流程 CMOS-MEMS 喷墨打印头工艺平台，公司将补齐领域技术空白，推进部分产品国产化替代进程，现有 6 款产品顺利通过客户验证，正式开展风险量产。

6. 氧化镓单晶衬底与外延材料技术取得阶段性领先成果，

已完成 4 吋氧化镓单晶晶锭生长，并加工出 4 吋高质量氧化镓单晶衬底片；完成大尺寸外延片参数工艺优化，初步实现 10 μ m 厚度 6 吋外延生长；同时，完成氧化镓器件设计与工艺整合。

（二）推动下游应用向高端转型

报告期内，公司积极拓展智能终端及新兴领域，产品与方案板块下游终端应用主要围绕五大领域，其中泛新能源（车类及风光储）占比 37%，智能终端相关应用占比 22%，家电（含智能家居）占比 21%，工业设备占比 12%，新兴领域占比 8%。

今年以来，汽车电动化与高阶智驾加速渗透，风光储新能源持续扩容，整体泛新能源领域营收实现同比增长。AI 端侧应用快速发展，为智能家居、智能终端带来创新机遇，产品升级换代驱动芯片需求量持续增长，公司依托 MCU、PMIC、IPM、IGBT、FRD 等产品组合加快切入，成功导入核心客户并快速起量，助力家电及智能终端领域实现较快增长。

在新兴领域，公司围绕数据中心、通讯、光芯片数据传输等云端场景，以及机器人、低空经济等终端应用，形成全链路解决方案布局，并在关键领域头部客户中实现快速起量，为后续业绩增长奠定坚实基础。公司将持续深耕高价值市场，优化产品结构，稳步提升综合竞争力。

三、以奋斗者为本，深入实施人才强企战略

公司始终将人才视为高质量发展的第一资源，持续打造结构合理、素质优良、富有战斗力的半导体人才队伍。截至报告期末，公司共有研发技术人员 4,601 名，占员工总数比例 40%，人才密度稳步提升。核心技术人员多具有十年以上半导体行业

研发经验，具备扎实的技术功底与前瞻性视野，为公司产品迭代、工艺升级及客户需求响应提供了坚实的人才保障。

（一）深化分配制度改革，激发人才创新活力

2026 年，公司持续完善市场化薪酬分配机制，锚定“创新+业绩”双目标，构建短期激励与长期激励相衔接的薪酬体系。短期，通过工资总额管理、创新专项设置及销售激励优化等举措，加大对战新人才、关键岗位及高绩效人员的精准激励。长期，以多元化股权激励为抓手，将核心骨干利益与公司长远发展深度绑定，建立健全符合市场规律且体现央企特色的分配机制。同时，优化董事及高级管理人员薪酬结构，强化薪酬与经营业绩、市值表现的联动效应，对高精尖科技领军人才实施“一人一议”协议薪酬，增强对行业顶尖人才的吸引力与留存力。2026 年 3 月，公司顺利完成股权激励预留授予部分第二期解锁，289 名激励对象实际归属 68.13 万股第二类限制性股票，充分体现了激励机制的实效性。

（二）前瞻性布局人才培养，积蓄长远发展动能

公司持续完善人才培养体系，着力打造学习型组织，推进“管理+专业”双通道职业发展路径建设。报告期内，公司启动“AI+人才”专项培养计划，围绕半导体设计、制造、封测等核心环节，系统开展数字化技能提升与跨界融合能力培训，培育具备 AI 思维与产业深度结合能力的复合型人才队伍。此外，公司持续推进校企合作与产学研协同，积极引进优秀应届毕业生与行业成熟人才，不断充实后备力量，为公司在战略方向上的持续突破积蓄人才动能。

四、以投资者为本，与投资者共享发展成果

公司始终坚持稳定、持续、可预期的现金分红政策，积极回馈股东。2026年6月25日，公司完成2025年度现金分红，叠加已实施的半年度分红，2025年度总体派息率达15%，年度派息率较以往显著提高，切实兑现了对投资者的回报承诺。公司将于2026年半年度报告期后实施中期分红，进一步强化股东回报的及时性。

2026年是公司市值管理工作从体系搭建走向落地深化的关键一年。在前期完成市值管理制度体系构建的基础上，报告期内着力推动各项机制从“建章立制”向“见行见效”推进：一是建立常态化的复盘总结与跟踪评估机制，定期梳理市值表现、行业动态及同业对标情况，形成分析报告并反馈管理层；二是系统推进市值管理专题研究与对标分析，结合半导体行业特点和公司IDM商业模式优势，持续优化市值管理的策略路径与工具组合；三是将市值管理目标纳入相关部门及高级管理人员重点关注事项及绩效考核体系，依托公司重要会议的定期部署与推动，市值管理工作上升为管理层共同的战略关切和一致的行动共识。下一步，公司将继续统筹推进经营质效提升、投资者回报增强与资本市场沟通协同，持续完善市值管理长效机制，切实推动公司投资价值合理反映内在经营质量，努力为股东创造持续、稳定的长期回报。

五、完善公司治理，以卓越董事会实现高效管理

公司持续构建权责法定、协调高效、科学规范的治理体系。2026年上半年，以卓越董事会建设为抓手，在信息披露、制度

优化、董事履职效能提升及经理层执行落实等关键领域持续精进，为公司长期稳健发展构筑坚实的治理保障。

（一）秉持“高标准、严要求”原则，实现高质量信息披露

2026年上半年，公司严格遵守监管要求，持续健全信息披露管理体系，确保披露内容真实、准确、完整、及时。报告期内，公司共披露公告文件49份，有效传递公司价值，保障信息披露透明度。公司连续三年在上海证券交易所科创板信息披露工作评价中获评“A”级，切实保障投资者知情权，持续提升公司规范运作水平和市场公信力。

（二）立足“系统化、规范化”方向，完善公司治理制度

报告期内，公司对照最新法律法规及监管规定，全面梳理评估现行制度体系，修订完善公司治理相关制度。2026年1月，公司股东会审议通过了《华润微电子有限公司股东会议事规则》《华润微电子有限公司对外担保管理办法》《华润微电子有限公司关联交易决策制度》等制度，制度内容涵盖股东会规范运作、对外担保审批及关联交易管理等方面。公司将抓好各项制度的落地执行，确保制度要求切实转化为治理实效。

（三）聚焦“独立性、专业性”要求，强化外部董事和独立董事履职

公司积极为董事履职提供充分保障。2026年上半年，外部董事人均履职50个工作日，独立董事人均履职43个工作日。公司有效组织董事参与股东会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，针对重要议题在会前与董事充分沟通；邀请董事出席战略经营会、业绩说明会等关键会议；组织董事参

加行业及上市公司专业培训，定期传递行业动态及公司经营信息。同时，积极安排董事调研下属单位并与管理层深入座谈，为董事会科学决策和公司高质量发展提供有力支撑。

（四）围绕“常态化、制度化”机制，持续落实经理层向董事会报告机制

2026年4月，公司召开2025年年度董事会，董事长代行总裁职责作《2025年年度总裁工作报告》，并向董事会报告了董事会授权决策事项的行权情况。公司持续强化董事会战略引领与经理层执行落地的有机衔接，进一步规范经理层向董事会定期汇报机制，切实提升公司治理效能和运营效率。

六、合规严谨做好投关管理，多措并举提高上市公司质量

公司始终将投资者关系管理视为连接资本市场与公司长期价值的关键纽带，在合规披露的基础上，注重与市场保持开放、务实的沟通，以专业视角回应投资者关切，努力增进市场对公司经营逻辑与发展战略的理解与认同。

（一）高质量召开业绩说明会，系统传递公司长期价值

公司将业绩说明会视为价值传递的重要平台。2026年4月24日，公司召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会，公司董事长、董事会秘书、独立董事出席会议，向百余家机构及个人投资者深度解读经营业绩及战略布局。此外，公司先后于5月8日参加上交所“科创板集成电路核心技术攻关”集体业绩说明会、5月12日出席“无锡市辖区上市公司投资者集体接待日”活动，集中展现公司在半导体领域的技术积淀与国产替代进程，进一步拓宽价值传递覆盖面。

（二）常态化推进投资者互动，持续优化股东结构与价值认知

公司通过策略会、路演及现场调研等方式，保持与资本市场的常态化、多维度互动。积极引入认同公司长期价值的机构股东，持续优化股东结构，围绕 IDM 商业模式优势、产能布局和新市场拓展等主线，引导市场关注公司长期成长空间，助力投资者形成稳定的价值预期。此外，公司积极参加上交所组织的投资者教育主题活动，分别于 6 月 5 日、7 月 22 日接待投资者近 80 人，增进个人投资者对公司经营情况及发展战略的了解。

（三）建设多渠道沟通体系，切实保障中小投资者知情权

公司持续完善多渠道沟通体系，覆盖官方网站投资者关系专栏、微信公众号、投资者热线及专用邮箱，便于投资者及时获取信息、反馈诉求。每月梳理投资者集中关注问题，通过披露《投资者关系活动记录表》予以集中回应，增进市场对公司经营节奏的理解。报告期内，通过“上证 e 互动”平台答复投资者提问 42 次，答复率 100%，切实保障中小投资者知情权。

（四）打造研究型 IR，以专业洞察赋能市值管理质效

公司着力推动投资者关系向研究驱动型工作模式转型，IR 专业人员围绕公司聚焦的功率半导体、智能传感器与智能控制等核心产品赛道开展行业趋势研判与竞争格局分析，跟踪 AI 算力、新能源汽车、风光储等下游需求变化对公司业务的传导影响，形成系统性研究，为对外沟通提供数据与逻辑支撑。同时，开展对标分析与研究，及时将市场洞察反馈至经营层面，

实现资本市场认知与公司决策的有效衔接，持续提升价值传递的专业性与前瞻性。

七、全面贯彻“ESG”理念，坚定执行“双碳”战略

公司深刻洞悉 ESG 管理对企业可持续发展与价值增长的支撑作用，高度重视 ESG 体系建设与品牌塑造。立足“十五五”开局之年，锚定公司自有 ESG 品牌建设目标，将可持续发展理念深度融入顶层战略规划与生产经营，推动 ESG 工作从“合规披露”转向“价值创造”、从“项目实践”升级为“体系化治理”，全方位打造具备行业影响力的可持续发展企业。

（一）夯实 ESG 治理，以高标合规筑牢可持续发展基石

公司连续 13 年编制发布可持续发展报告/社会责任报告，连续三年发布英文版报告，2026 年首次发布独立鉴证报告，全方位提升信息披露完整性、规范性与可信度，筑牢合规披露根基。在此基础上，进一步压实各级主体报送责任，建立常态化、标准化的信息报送机制，加强 ESG 纵深管理。

（二）打造“SPRING”品牌，以特色行动诠释价值主张

公司完成打造 ESG 自有品牌“SPRING 芯芯向荣”，形成公司 ESG 品牌资产，为后续 ESG 传播与价值输出提供核心载体。品牌形象以“SPRING 芯芯向荣”中英文融合视觉呈现，品牌标识融合绿叶、晶圆、电路、华润微简称等元素，绿叶象征绿色发展，“芯”字呼应半导体主业，传递企业与社会可持续发展的双重愿景。同时，公司规划了“绿色低碳、以人为本、和谐共生、科技创新、携手共赢、暖芯行动”六大行动方向，以实际行动夯实 ESG 品牌塑造。



(ESG 品牌图解)

(三) 深化 ESG 业务协同，以实效举措驱动绿色低碳转型

公司推动 ESG 管理与生产经营深度融合。绿色供应链方面，制定并发布《供应商商业行为准则》《负责任矿物声明》，要求供应商签署相关承诺；碳管理方面，推动公司在报告期内首次完成开展全范围（范围 1、范围 2、范围 3）碳盘查；乡村振兴方面，针对革命老区清流县开展化学品采购，截至 2026 年上半年同比增长 42%。

(四) 获取权威评级认可，以卓越表现跻身 ESG 第一梯队

公司 ESG 表现持续获资本市场高度认可，连续两年获得中国企业社会责任报告评级专家委员会“五星级卓越报告”评价；连续两年获国内知名 ESG 评级机构 Wind “AA 级”评价，位列同类行业第一梯队；入选万得中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强（大市值）；在中国社科院课题组最新发布的半导体行业社会责任发展指数提升至第三名等。

本公告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到外部经济环

境、行业市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。